

株式会社フェローテック

会社紹介資料

2025年9月



FerroTec

会社紹介

| | | | |
|------|----------------------------|--------|------------------------------|
| 商号 | 株式会社フェローテック | 資本金 | 295億4,942万円 |
| 英文表記 | Ferrotec Corporation | 発行済株式数 | 47,117,949株(自己株式297,422株を含む) |
| 設立 | 1980年9月27日 | 関連会社 | [連結子会社] 80社 [持分法適用子会社] 13社 |
| 本社 | 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル 5F | 従業員 | [連結] 15,983名 [単体] 583名 |
| 株式公開 | 東証スタンダード(証券コード:6890) | | |
| 代表者 | 代表取締役社長／グループCEO 賀 賢漢 | | |

主な事業内容

1. 半導体等装置関連事業製品の製造販売

(真空シール、石英製品、セラミックス製品(ファインセラミックス、マシナブルセラミックス)、シリコンパーツ、CVD-SiC製品、石英坩堝、シリコンウエーハ、受託加工・組立等)

2. 電子デバイス事業製品の製造販売

(サーモモジュール、パワー半導体用基板、サーミスタ、磁性流体)

3. 車載関連事業製品の製造販売

(サーモモジュール、パワー半導体用基板、サーミスタ)

4. その他関連事業セグメント

(機械刃物、産業用クリーニング機器、インゴット引き上げ装置等)

顧客に満足を 地球にやさしさを 社会に夢と活力を

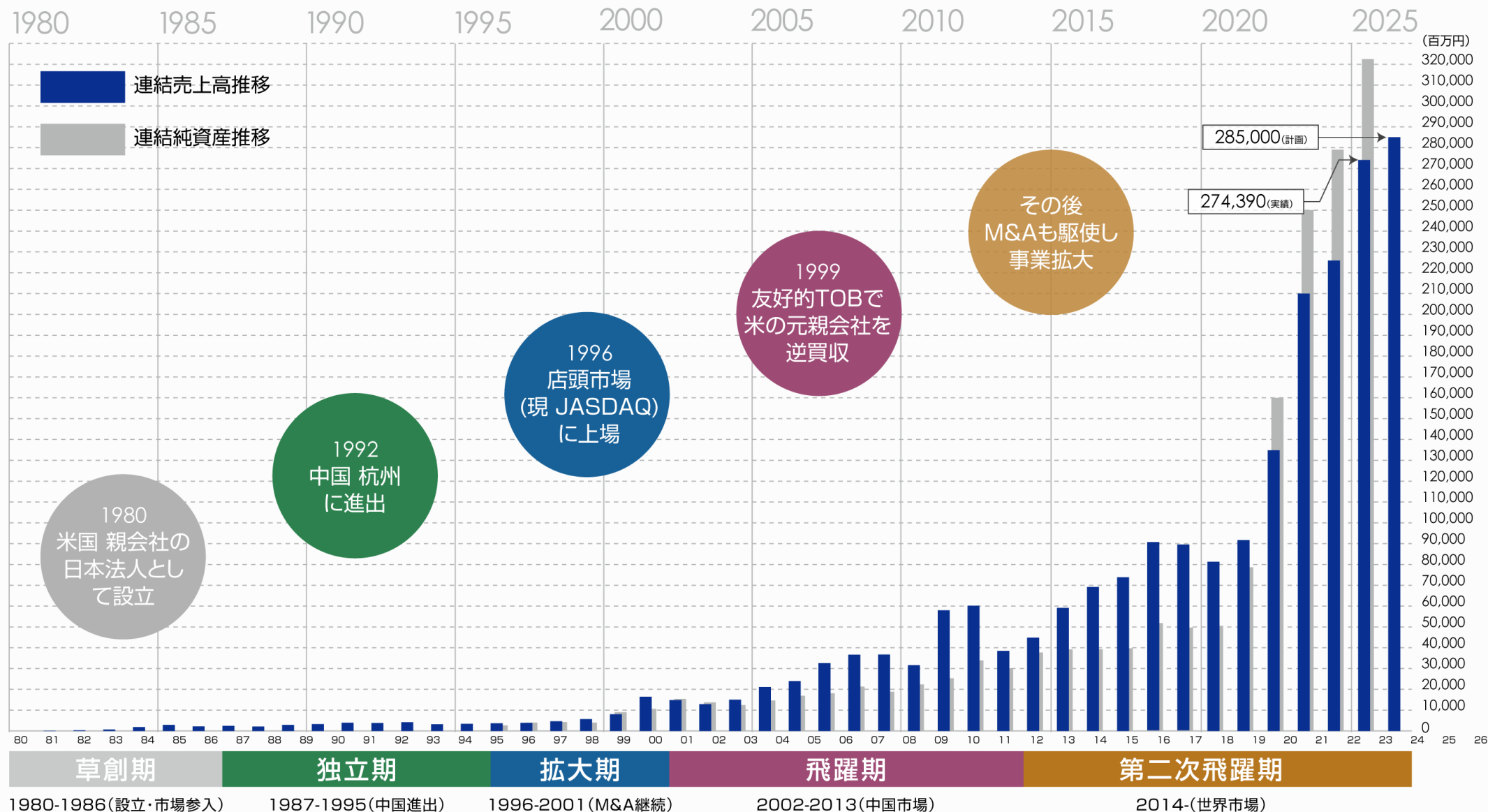
気づき、改善し、幸せを追求する企業。
それが私たちフェローテックです。

フェローテックはグローバルな視点のもと
国際社会や地域社会と調和を図り、
あらゆる人々の生活に貢献できる製品と
サービスを提供する企業として誠実に行動します。

お客様から信頼されて満足を頂くこと
地球環境問題の解決に貢献すること
ものづくりを通して社会に貢献することを掲げます。



会社の歩みと連結売上高の推移



事業概要

コア技術

- ・ 当社事業の源流は「磁性流体」磁性流体応用製品の「真空シール」と温調デバイスの「サーモモジュール」で世界トップシェア

M&A

- ・ 元来保有する事業以外を積極的なM&Aや戦略的提携で獲得し、相乗効果を最大限に発揮

4 素材

- ・ 半導体装置向部材：4 素材（石英・セラミックス・シリコンパーツ・CVD-SiC）を保有
- ・ 半導体製造装置メーカーの様々な課題をワンストップで対応可能

量産能力

- ・ 製品を「米国で開発」→「日本で確立」→「中国で量産」で30年来運営
- ・ 近年の市場動向や顧客ニーズに基づき、マレーシアと日本でも量産拠点を展開

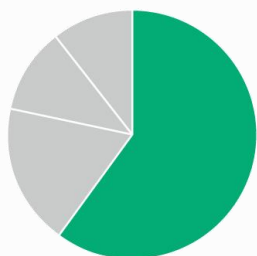
世界の顧客

- ・ 日米欧だけでなく、中国国内においても優良企業と取引
- ・ 世界的企業から各種表彰を受けるなど、サプライヤーとして高評価・信頼を獲得

成長性

- ・ 会社の持続的な成長を追及し、株主にとって成長が楽しみな企業を意識

セグメント別 売上高構成比

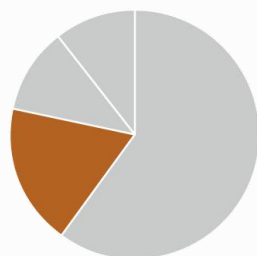


60.2%

半導体等装置関連セグメント



真空シール／石英製品
ファインセラミックス
シリコンパーツ
SiCパーツ (CVD-SiC)
スーパーマシナブルセラミックス
再生ウエーハ／石英るつぼ
装置部品洗浄／EBガン
精密蒸着装置／受託加工
半導体用シリコンウエーハ
SiCウエーハ

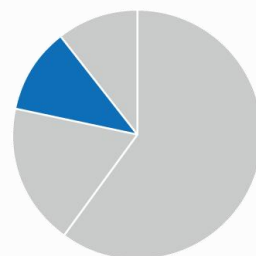


18.4%

電子デバイスセグメント



サーモモジュール
パワー半導体用基板
サーミスタ
磁性流体

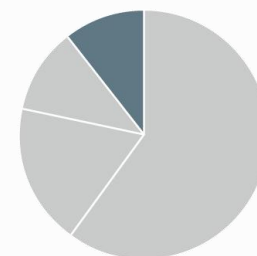


11.1%

車載関連事業セグメント



サーモモジュール・
アプリケーション
パワー半導体用基板
センサ



10.3%

その他関連事業セグメント

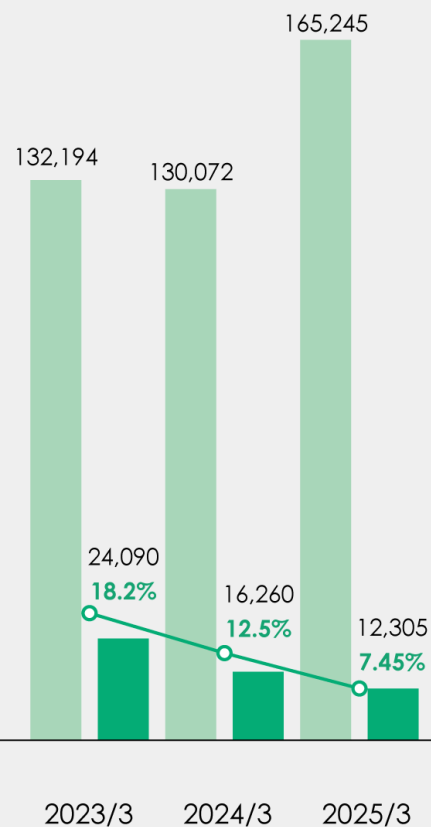


工業用刃物
木工・金属加工用刃物
産業用クリーニング機器
インゴット引き上げ装置
各種製造装置

セグメント別 業績詳細

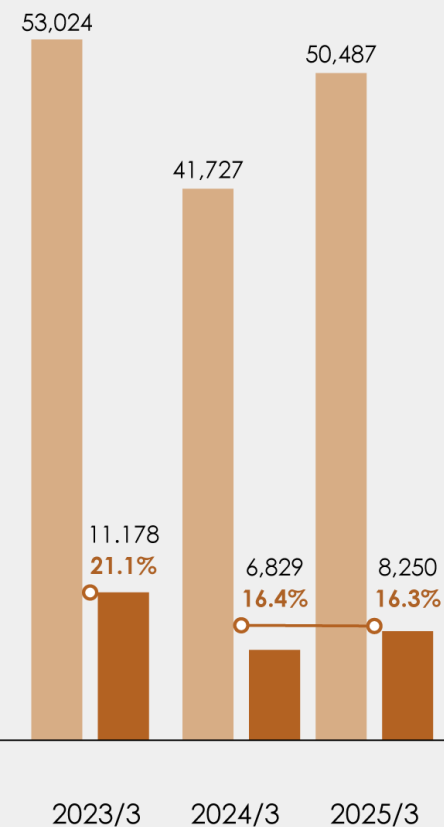
半導体等装置関連セグメント

売上高(百万円) 営業利益(百万円)
営業利益率



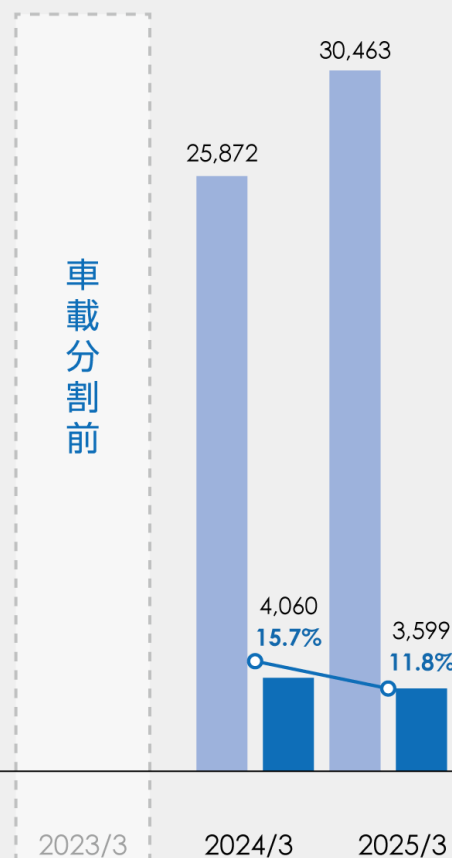
電子デバイスセグメント

売上高(百万円) 営業利益(百万円)
営業利益率



車載関連事業セグメント

売上高(百万円) 営業利益(百万円)
営業利益率



その他関連事業セグメント

売上高(百万円) 営業利益(百万円)
営業利益率



半導体等装置関連事業

半導体等装置関連事業では、半導体製造装置向け、FPD製造装置向けを中心に様々な製品・サービスを取り扱っております。磁性流体技術を応用した真空シール半導体製造装置で使用するマテリアル製品(石英、セラミックス、シリコンパーツ、CVD-SiC等)や、金属受託加工サービス、部品洗浄サービスなどを手掛けております。また、製品量産化のために必要な技術とノウハウを豊富に蓄積しております。



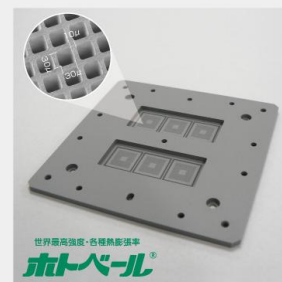
真空シール
Vacuum Seals



石英製品
Quartz Products



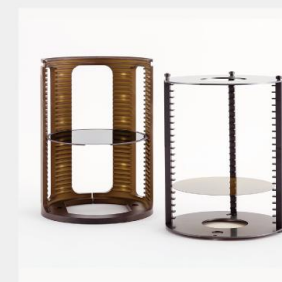
ファインセラミックス
Fine Ceramics Products



スーパーマシナブルセラミックス
Machinable Ceramics Products



シリコンパーツ
Silicon Parts



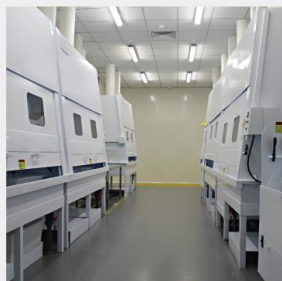
SiCパーツ (CVD-SiC)
SiC Parts



石英るつぼ
Quartz Crucibles



受託加工・組立
CMS



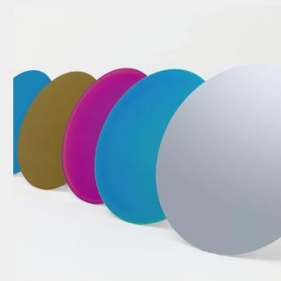
装置部品洗浄
Process Tools Parts Cleaning



EBガン
EB Components



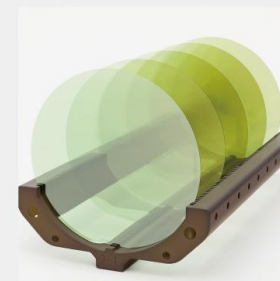
精密蒸着装置
Vacuum Coating System



再生ウエーハ
Reclaim Wafer



半導体用シリコンウエーハ
Silicon Wafers
※持分法適用関連会社



SiCウエーハ
SiC Wafer
※持分法適用関連会社

未来を創る半導体 その基盤を支えるフェローテック

半導体は数多くの工程を経て製造されます。
フェローテックの技術と製品は、その製造工程で
欠かせない存在となっています。

最新の技術トレンドに対応する製品群

技術革新に伴うこれからの半導体需要にフェローテックの半導体事業
は部材から加工まで数多くの製品で網羅します。



真空シール

高性能かつ高い歩留まりを誇る半導体は、製造工程において不純物のない密閉空間の確保が重要です。当社の装置関連製品は多くの工程でその性能を発揮します。

マテリアル製品

ウエーハ製造プロセスでは、当社のマテリアル製品は薄膜生成、
搬送、洗浄工程で治具、消耗品として利用されています。

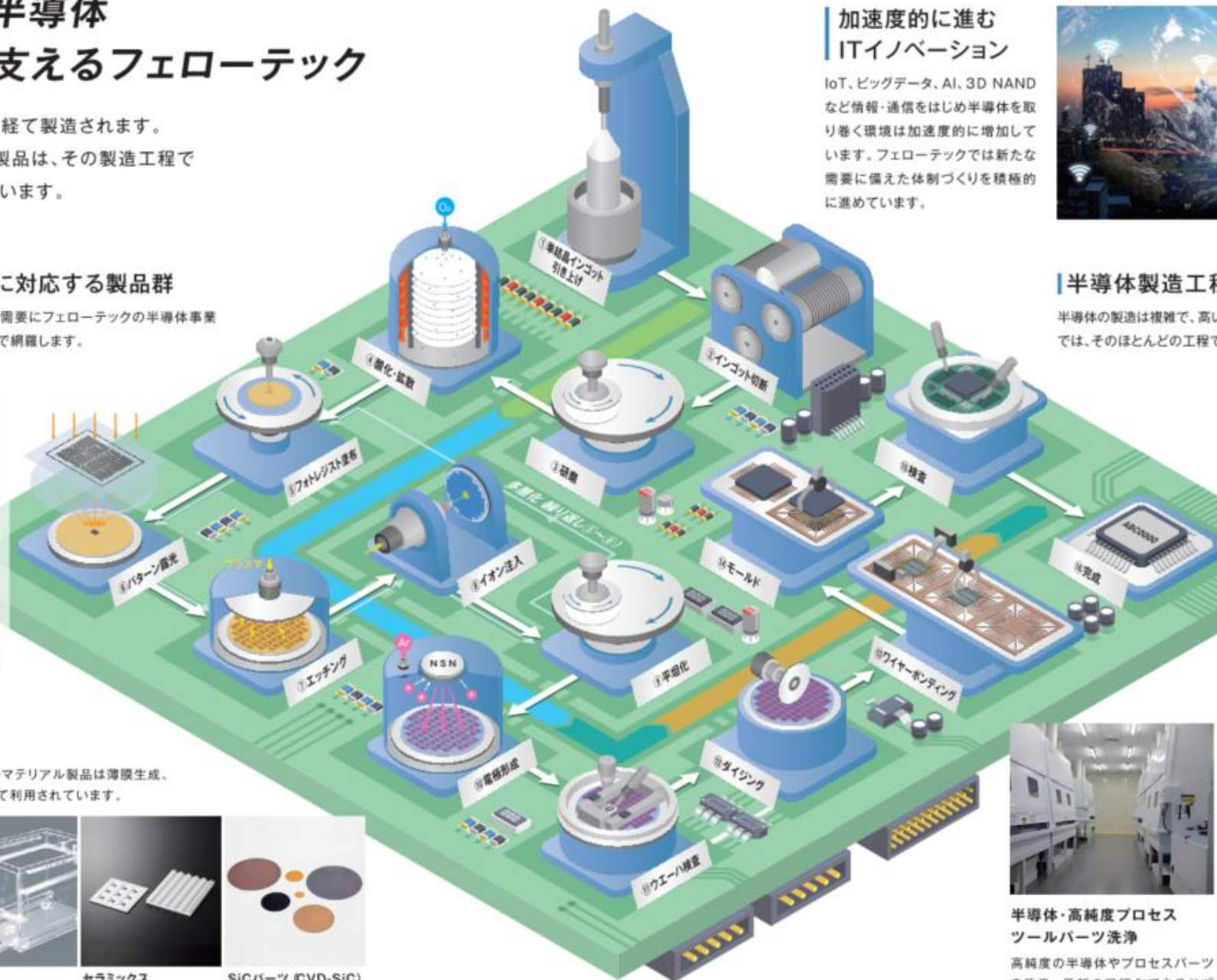


シリコンパーツ

石英製品

セラミックス

SiCパーツ (CVD-SiC)



加速度的に進む ITイノベーション

IoT、ビッグデータ、AI、3D NAND
など情報・通信をはじめ半導体を取り
巻く環境は加速度的に増加して
います。フェローテックでは新たな
需要に備えた体制づくりを積極的
に進めています。



半導体製造工程で貢献

半導体の製造は複雑で、高い技術力を必要とします。フェローテック
では、そのほとんどの工程で利用可能な製品を提供しています。



シリコンウエーハ生産

中国工場でシリコンウエーハを単結
晶から一貫製造しています。6インチ
以下の小口径に続き、2017年度より
8インチウエーハの生産を開始。



半導体・高純度プロセス ツールパーツ洗浄

高純度の半導体やプロセスパーツ
を洗浄。最新の微細化であるサブ
28nmにも対応します。

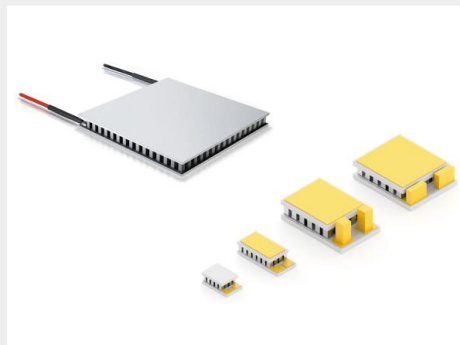


受託加工

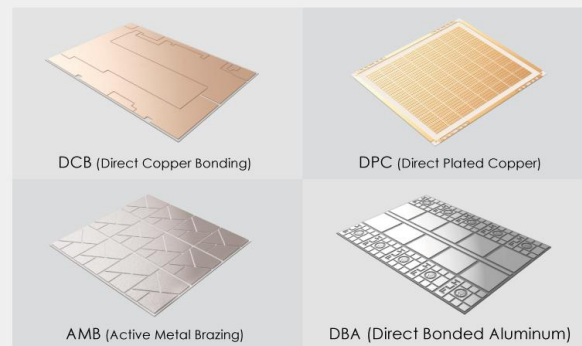
真空シールやシリコン結晶引き上げ
装置で培った精密金属加工技術や
装置生産技術によりお客様のニーズ
にお応えします。

電子デバイス事業

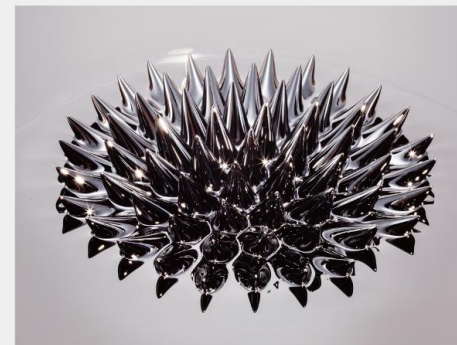
電子デバイス事業では、サーモモジュール(ペルチェ素子)、パワー半導体用基板、磁性流体、温度センサ(サーミスタ)等を取り扱っております。これらの製品は用途範囲が広く、医療機器や半導体、通信分野、産業機器など幅広い産業で活躍しています。また、用途や仕様に合わせ様々なカスタマイズに対応しております。



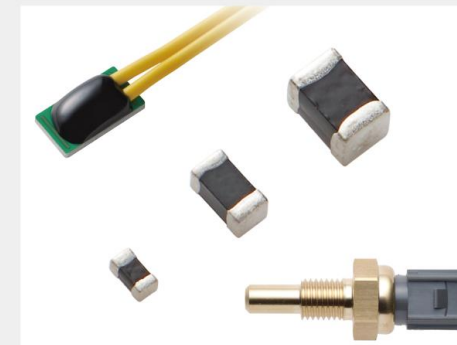
サーモモジュール
Thermoelectric Modules



パワー半導体用DCB, AMB, DPC, DBA基板
Power Semiconductor DCB, AMB, DPC, DBA Substrates



磁性流体
Ferrofluid

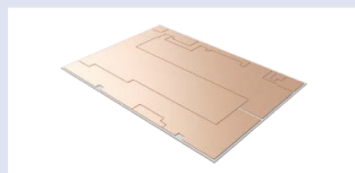


サーミスタ
Thermistor Sensors

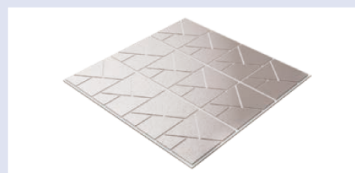
車載関連事業

半導体市場を中心に成長する当社は、今後EV（電気自動車）、PHV（プラグインハイブリット車）、自動運転システム等、アプリケーションの大きな変化が見込まれる自動車市場向けに、パワー半導体用基板、サーモモジュール（ペルチェ素子）、温度センサ（サーミスタ）などの導入を進めてまいります。

【主な製品】 パワー半導体用基板



DCB基板



AMB基板

【主な製品】 サーミスタ



サーミスタ

ヘッドランプ制御

ルームランプ制御

AV・アクセサリ制御

ステアリング制御

モータ制御

トランスミッション制御

ブレーキ制御

吸気エア量用

吸気エア温用

車内温度用

ディーゼル燃温用

ラジエーター水温用

レーザーレーダー

ヘッドアップディスプレイ

ADAS(先進運転支援システム)

GPU(画像処理装置)クーラー

CMOS(相補型金属酸化膜半導体)クーラー

レーザーヘッドライト

シートクーリングシステム

ステアリングヒーター/クーラー

クーラボックス

カップホルダー

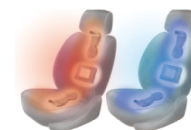
ヒーター/エアコン

バッテリークーリング

【主な製品】 サーモモジュール



レーザーレーダー



自動車用温調シート



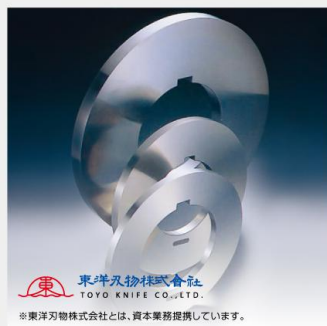
クーラボックス



カップホルダー

その他関連事業

フェローテックグループでは、主力事業以外にも、情報産業用、鉄鋼用、木工・金属用の刃物、リネン系分野の業務用洗濯機、シリコンやSiCのインゴット引き上げ装置なども手掛けております。これらの製品は日本や中国をはじめ、その他の海外拠点や事業ネットワークを通じ、世界中のお客様にお届けしております。



工業用刃物

Industrial knife



木工・金属加工用刃物

Wood processing /
Metalworking sawblade



産業用クリーニング機器

Industrial Cleaning



12インチ半導体用
単結晶引き上げ装置

12-inch Semiconductor
Single Crystal Silicon Ingot Puller



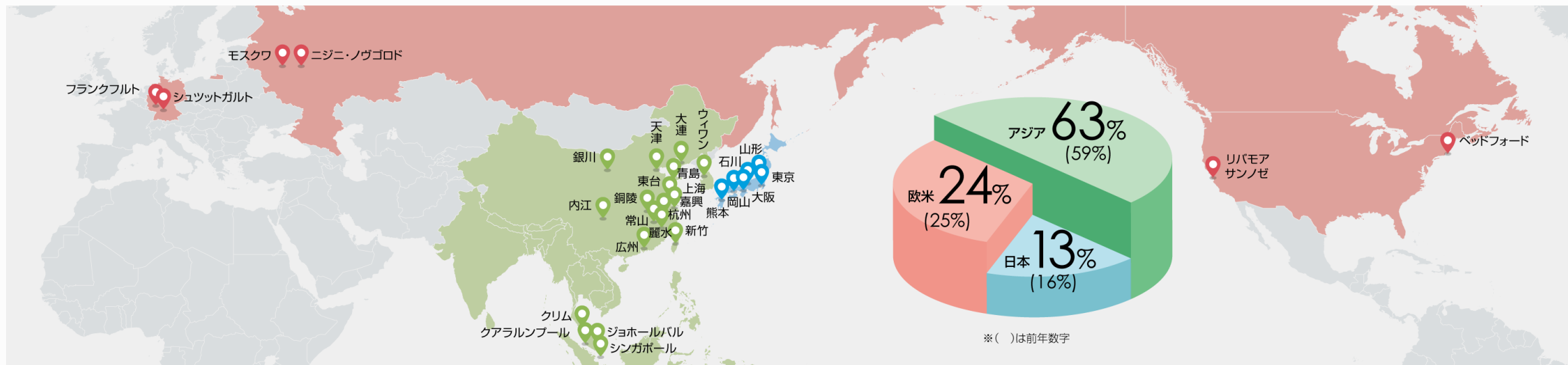
6～8インチSiC引き上げ
インゴット引き上げ装置

6-8 inch SiC Puller



各種製造装置

Various production equipments



欧州

📍 **フランクフルト(ドイツ)** 🏭

📍 **シュツットガルト(ドイツ)** 🏭
生産品目: EBガン(蒸着装置向け電子銃)

📍 **モスクワ(ロシア)** 🏭
生産品目: サーマモジュール

📍 **ニジニ・ノヴゴロド(ロシア)** 🏭
生産品目: マイクロモジュール

アジア

📍 **杭州** 🏭 生産品目: サーマモジュール(組立)、真空シール、石英、セラミックス、シリコンパーツ、受託加工、ソーブレード、半導体用ウエーハ

📍 **上海** 🏭 生産品目: サーマモジュール(素材)、パワー半導体用基板、半導体用ウエーハ、部品洗浄

📍 **銀川** 🏭 生産品目: 半導体用石英つぼ、半導体用インゴット、シリコンパーツ

📍 **銅陵** 🏭 生産品目: 部品洗浄、再生ウエーハ、SiCウエーハ

📍 **東台** 🏭 生産品目: パワー半導体用基板、研究院、石英

📍 **常山** 🏭 生産品目: 石英、サーモモジュール、受託加工

📍 **天津** 🏭 生産品目: 部品洗浄

📍 **大連** 🏭 生産品目: 部品洗浄

📍 **広州** 🏭 生産品目: 部品洗浄

📍 **青島** 🏭 生産品目: 部品洗浄

📍 **新竹(台湾)** 🏭

📍 **シンガポール** 🏭

📍 **クアラルンプール(マレーシア)** 🏭

📍 **クリム(マレーシア)** 🏭

📍 **ジョホール・バル(マレーシア)** 🏭

📍 **ウィワン(韓国)** 🏭

📍 **内江** 🏭 生産品目: 部品洗浄、パワー半導体用基板

📍 **麗水** 🏭 生産品目: エピタキシャルウエーハ

📍 **嘉興** 🏭 生産品目: 車載関連用サーモモジュールアプリケーション

日本

📍 **東京[本社]** 🏭 販売拠点: 仙台営業所、関西営業所、熊本営業所

📍 **千葉工場** 🏭 生産品目: 真空シール、磁性流体

📍 **関西工場** 🏭 生産品目: ファインセラミックス

📍 **石川工場・第2・第3工場** 🏭 生産品目: マシナブルセラミックス

📍 **石川開発センター** 開発テーマ: 各種セラミックスの材料・加工技術

📍 **岡山工場** 🏭 生産品目: CVD-SiC

📍 **山形工場** 🏭 生産品目: 石英製品

米国

📍 **ベッドフォード** 🏭 生産品目: 真空シール、磁性流体

📍 **リバモア** 🏭 生産品目: 精密蒸着装置

📍 **サンノゼ** 🏭 生産品目: 真空装置、真空部品

連結売上高構成比

■ **アジア:** 173,824(百万円)

■ **日本:** 35,950(百万円)

■ **欧米:** 64,616(百万円)

2025年3月期合計売上高

2,744億円
(前年度売上高 2,224億円)

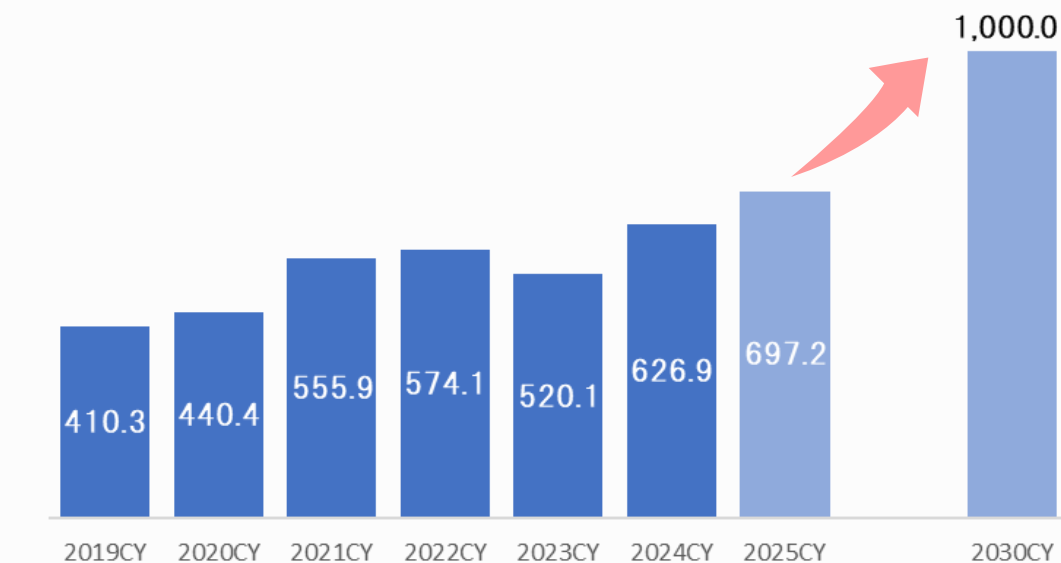
🏭 生産拠点
👤 販売拠点

経営数値等

半導体・半導体製造装置市場の見通し

- ▶ WFE（半導体製造装置）は中国向け輸出の減少等の影響で横ばい
- ▶ 米国における政策先行き見通せず足許は不透明も、中長期的には市場は伸長予測

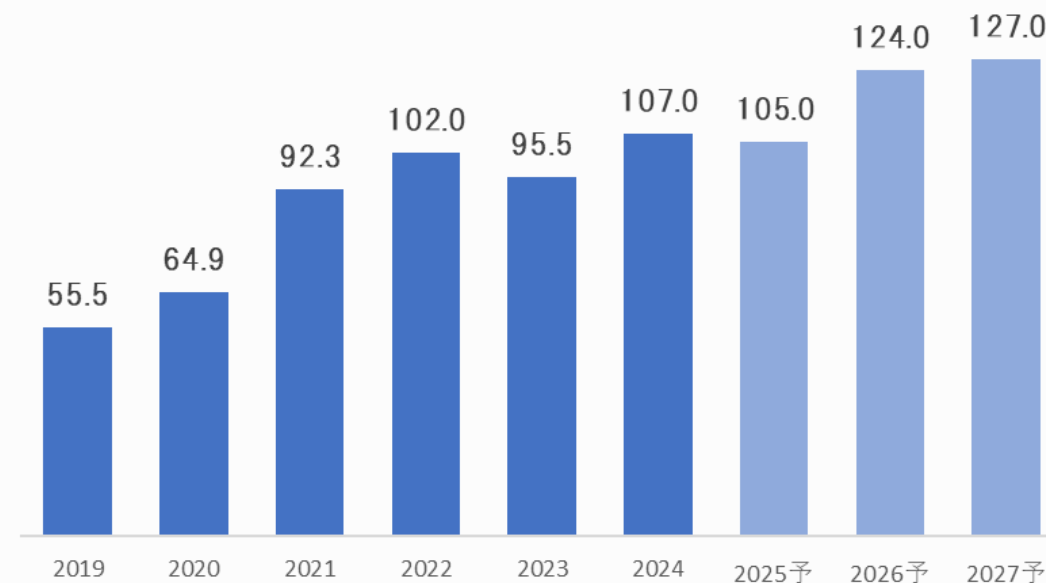
半導体市場予測



| (10億米ドル) | 2019CY | 2020CY | 2021CY | 2022CY | 2023CY | 2024CY | 2025CY |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 半導体需要 | 410.3 | 440.4 | 555.9 | 574.1 | 520.1 | 626.9 | 697.2 |
| 前年比成長率 | -0.5% | +7.3% | +26.2% | +3.3% | -9.4% | +20.5% | +11.2% |

※WSTS発表資料

WFE（半導体製造装置前工程）市場予測



| (10億米ドル) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025予 | 2026予 | 2027予 |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| WFE市場金額 | 55.5 | 64.9 | 92.3 | 102.0 | 95.5 | 107.0 | 105.0 | 124.0 | 127.0 |
| 前年比成長率 | -6.0% | +16.9% | +42.2% | +10.5% | -6.4% | +12.0% | -1.9% | +18.1% | +2.4% |

※某証券会社統計を一部加工

中期経営計画 K P I

| (百万円) | 25/3期 (実) | 26/3期 (予) | 27/3期 (計) | 28/3期 (計) |
|---------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 売上高 | 274,390 | 285,000 | 340,000 | 400,000 |
| 営業利益 | 24,089 | 28,000 | 35,000 | 47,000 |
| 営業利益率 | 8.8% | 9.8% | 10.3% | 11.8% |
| 当期純利益 | 15,692 | 16,000 | 20,000 | 29,000 |
| ROE | 7.1% | | | 15% |
| ROIC* | 3.9% | | | 8% |
| 自己資本比率 | 39.4% | 40% | | |
| 設備投資 | 51,776 | 65,000 | 45,000 | 30,000 |
| 1株当たり配当金 (年間) | 141.0円 | 148.0円 | <ul style="list-style-type: none"> DOE (連結株主資本配当率**) を採用し、下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す | |

*ROIC = 親会社帰属純利益 ÷ (有利子負債 + 純資産)、純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

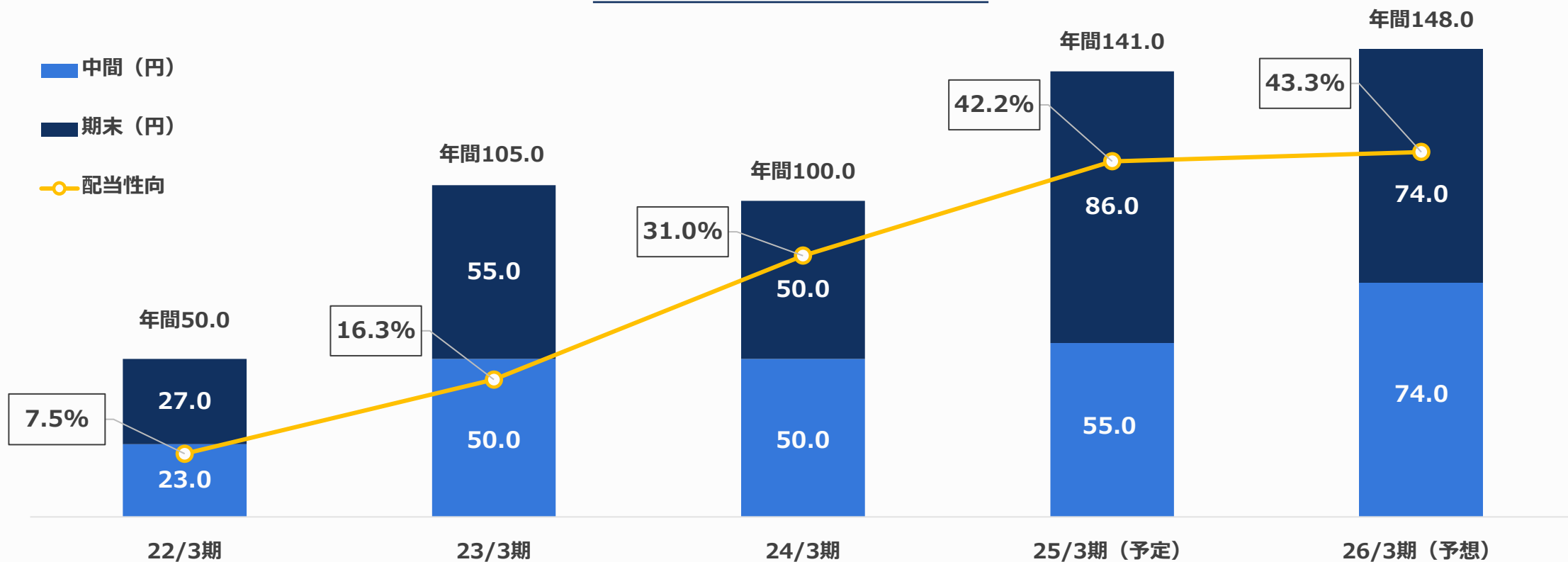
**連結株主資本 = 資本金 + 資本剰余金 + 利益剰余金 - 自己株式、連結株主資本配当率 = 配当金総額 ÷ 連結株主資本

26/3期 セグメント・製品別の業績予想（上期・下期）

| (百万円) | 25/3期 実績 | | | 26/3期 予想 | | | | | |
|-----------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 通期 | 上期 | 下期 | 通期 | 前期比 | 上期 | 前年同期比 | 下期 | 前年同期比 |
| 半 導 体 等 装 置 関 連 | 165,245 | 84,042 | 81,202 | 177,402 | 7.4% | 84,210 | 0.2% | 93,192 | 14.8% |
| 真空シール・金属加工 | 39,195 | 19,347 | 19,848 | 49,774 | 27.0% | 24,395 | 26.1% | 25,379 | 27.9% |
| 石英製品 | 31,930 | 16,134 | 15,795 | 31,930 | 0.0% | 15,634 | △ 3.1% | 16,296 | 3.2% |
| シリコンパーツ | 13,687 | 7,172 | 6,514 | 12,968 | △ 5.3% | 6,485 | △ 9.6% | 6,483 | △ 0.5% |
| セラミックス | 33,155 | 15,448 | 17,707 | 39,142 | 18.1% | 17,647 | 14.2% | 21,495 | 21.4% |
| CVD-SiC | 8,192 | 3,992 | 4,199 | 8,162 | △ 0.4% | 3,728 | △ 6.6% | 4,434 | 5.6% |
| EBガン・LED蒸着装置 | 8,242 | 4,076 | 4,166 | 6,127 | △ 25.7% | 2,737 | △ 32.9% | 3,390 | △ 18.6% |
| ウエーハ加工 | 10 | 10 | △0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 再生ウエーハ | 2,856 | 1,251 | 1,605 | 4,427 | 55.0% | 2,137 | 71.0% | 2,290 | 42.5% |
| 部品洗浄 | 15,306 | 7,061 | 8,245 | 17,597 | 15.0% | 8,247 | 16.8% | 9,350 | 13.4% |
| 石英坩堝 | 12,668 | 9,547 | 3,121 | 7,275 | △ 42.6% | 3,199 | △ 66.5% | 4,076 | 30.6% |
| 電 子 デ バ イ ス | 50,487 | 23,085 | 27,401 | 56,921 | 12.7% | 27,150 | 17.6% | 29,771 | 8.6% |
| サーモモジュール | 27,225 | 12,431 | 14,794 | 31,181 | 14.5% | 14,858 | 19.5% | 16,323 | 10.3% |
| パワー半導体基板 | 18,152 | 8,692 | 9,460 | 16,719 | △ 7.9% | 8,680 | △ 0.1% | 8,039 | △ 15.0% |
| 磁性流体・その他 | 1,137 | 575 | 562 | 1,370 | 20.4% | 608 | 5.7% | 762 | 35.3% |
| センサ | 3,971 | 1,387 | 2,584 | 7,652 | 92.7% | 3,005 | 116.7% | 4,647 | 79.8% |
| 車 載 関 連 | 30,463 | 14,304 | 16,159 | 35,878 | 17.8% | 16,338 | 14.2% | 19,540 | 20.9% |
| サーモモジュール | 6,412 | 3,108 | 3,304 | 5,113 | △ 20.3% | 2,539 | △ 18.3% | 2,574 | △ 22.1% |
| パワー半導体基板 | 19,250 | 9,628 | 9,621 | 22,953 | 19.2% | 10,546 | 9.5% | 12,407 | 28.9% |
| センサ | 4,801 | 1,567 | 3,233 | 7,813 | 62.7% | 3,252 | 107.5% | 4,561 | 41.0% |
| そ の 他 | 28,194 | 13,723 | 14,470 | 14,799 | △ 47.5% | 7,303 | △ 46.8% | 7,497 | △ 48.2% |
| 合 計 | 274,390 | 135,157 | 139,233 | 285,000 | 3.9% | 135,000 | △ 0.1% | 150,000 | 7.7% |

- ▶ 株主還元の強化を図るため、新たにDOE（株主資本配当率）を採用し下限を3.5%設定
- ▶ 持続的な収益増強により配当水準の引上げを目指すとともに、財務の状況等を考慮しながら、自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指して充実を図っていく

1 株当たり配当金の推移



- ▶ IRポータルサイト「IR STREET」にIRニュースを掲載・メール配信しております。
以下のQRコードもしくはリンクより、配信先メールアドレスをご登録いただけます。

日本語



[登録ページリンクはこちら](#)

English



[Go to Registration Page](#)

- 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに 限定されるものではありません。
- 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

ご清聴ありがとうございました
